

证券代码：300606

证券简称：金太阳

东莞金太阳研磨股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2023-001

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 媒体采访 ☐ 新闻发布会 ☐ 现场参观	☐ 分析师会议 ☐ 业绩说明会 ☐ 路演活动 ☐ 其他（ <u>电话会议</u> ）
形式	☒ 现场 ☐ 网上 ☐ 电话会议	
参与单位名称及人员姓名	国海证券、德邦证券、中信证券、富国基金、侏罗纪资产、清淙投资、泰禾资本、纽富斯投资	
时间	2023年03月10日	
地点	公司会议室	
上市公司接待人员姓名	副总经理、董事会秘书 杜燕艳 证券事务代表 李金伟	
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司基本情况介绍 金太阳于2004年成立，立足于新材料研磨抛光的技术优势，积极进行产业链延伸布局，已发展成为行业第一家提供集抛光耗材、抛光液、高端智能装备以及抛光工艺于一体的国家高新技术企业。 下面介绍公司主要业务布局： （一）研磨抛光耗材。是一种用特殊配方的粘结剂将有磨削抛光功能的磨料粘结在布、纸、聚酯薄膜等可挠性基材上而制成的用于工件研磨和精密抛光的工具。主要应用市场有（1）汽车新车制造与旧车保养维修；（2）3C消费电子，主要用于各类精密结构件打磨抛光，如手机中框、手表表壳、小件等；（3）智能家居、木材、板材等；（4）不锈钢、铸件等。 （二）精密抛光液。领航电子抛光液主要应用于半导体及3C消费	

电子行业。（1）3C方面，3C精密抛光液主要用于各类精密结构件的打磨抛光，适用于钛合金、铝合金、蓝宝石衬底、微晶玻璃、不锈钢的粗抛或者镜面抛光，可配合公司的研磨耗材和设备为客户提供整体方案。（2）半导体方面，主要业务为衬底（如硅晶圆、碳化硅、氮化镓等）制造以及芯片制造工艺中的CMP抛光液。考虑到半导体行业用抛光液技术门槛和市场壁垒极高，产品验证周期相对较长，且对进口产品依赖仍然非常高，产品实现批量销售仍存在较大不确定性，特此提醒广大投资者注意投资风险。

（三）核心磨料业务。处于工艺优化和产品验证过程中，尚未形成销售。立志于做好核心技术沉淀、突破关键技术，长期目标为打破国外垄断，填补国内空白，实现产品进口替代。

（四）智能装备业务与精密结构件业务。智能装备业务主要产品有五轴数控抛磨机床、五轴力控抛光机、力控自动翻转毛刺机、吸尘气磨机、五合一（整形检测）一体机、自动上下料机等。目前主要客户为3C方面，部分汽车方面客户尚待验证。精密结构件的业务，一部分产能用于为公司设备生产提供机加工，提高公司零部件自主化；一部分产能用于精密结构件加工业务，主要涉及智能家居、3C消费电子、新能源汽车等领域。

二、交流互动

1、公司进入富士康等供应链体系后的发展情况？

答：公司持续加深与富士康、立讯精密、长盈精密、捷普、中国中车等大客户、重要客户的紧密联系，并持续跟进商飞系飞机制造及维修企业，进入客户供应商平台产品种类及数量持续增加。

2、公司纸基和布基研磨耗材的区别有哪些？

答：（1）基材的区别，纸基的基材以重磅纸、特种纸等为主，布基的基材主要是棉布。（2）应用的区别，布基因为耐用度较高主要用于粗加工，而纸基侧重于精抛。

3、新型抛光材料包括哪些，毛利如何？

答：公司的新型抛光材料包括新开发的金字塔产品、弹性抛光膜等产品，该产品主要用于精度要求更高的场景。毛利率相对较高，约为46%。

	4、公司智能数控装备业绩不佳的原因？ 答：公司智能装备受主要下游3C需求疲软、通货膨胀、供应链限制和持续的地缘政治紧张等宏观因素影响，相应业务有所影响。同时，公司设备产品验证周期较长，去年疫情防控政策调整后，部分产品验证、交付、验收等环节出现显著延迟甚至停滞，对公司业绩有所影响。 5、公司为客户提供抛光耗材以及设备一体化的解决方案有哪些优势？ 答：以往客户对产品进行研磨抛光处理，需要分别对抛光耗材厂商和设备厂商进行筛选采购，后继还需要三方配合反复多次调试才能达到稳定的研磨抛光效果，沟通磨合成本较高。公司提供的一体化解决方案，可根据客户的研磨抛光要求为客户提供系列化产品及服务，极大降低客户整体成本提高客户生产效率。 6、公司为客户提供抛光耗材以及设备一体化的解决方案，公司的新产品3C抛光液是否更容易进入客户的供应链渠道？3C的抛光液大概预期收入会有多少？ 答：由于3C抛光液业务尚处于起步阶段，全年的情况需以年度报告业绩为准。 7、3C的抛光液毛利率大概能达到多少？ 答：目前毛利率预计尚不准确，公司将在正式产业化、稳定经营情况作出准确计算。 8、公司半导体抛光液方面，目前是已经在批量供应了吗？ 答：半导体抛光液主要是参股公司东莞领航电子新材料有限公司的业务，目前硅晶圆衬底抛光液、第三代半导体衬底抛光液已有部分产品通过客户验证并逐步投放市场，批量供应尚存在较大不确定性。芯片抛光液方面，领航电子相关团队有二十多年的技术沉淀，丰富的产品研发和产业化经验。通过充足准备，芯片用抛光液产品的生产及验证等工作于今年初正式开展，同时，芯片用抛光液验证周期比3C和衬底抛光液时间可能更长，不确定性也更大。敬请投资者注意风险。
附件清单	无
日期	2023年03月10日